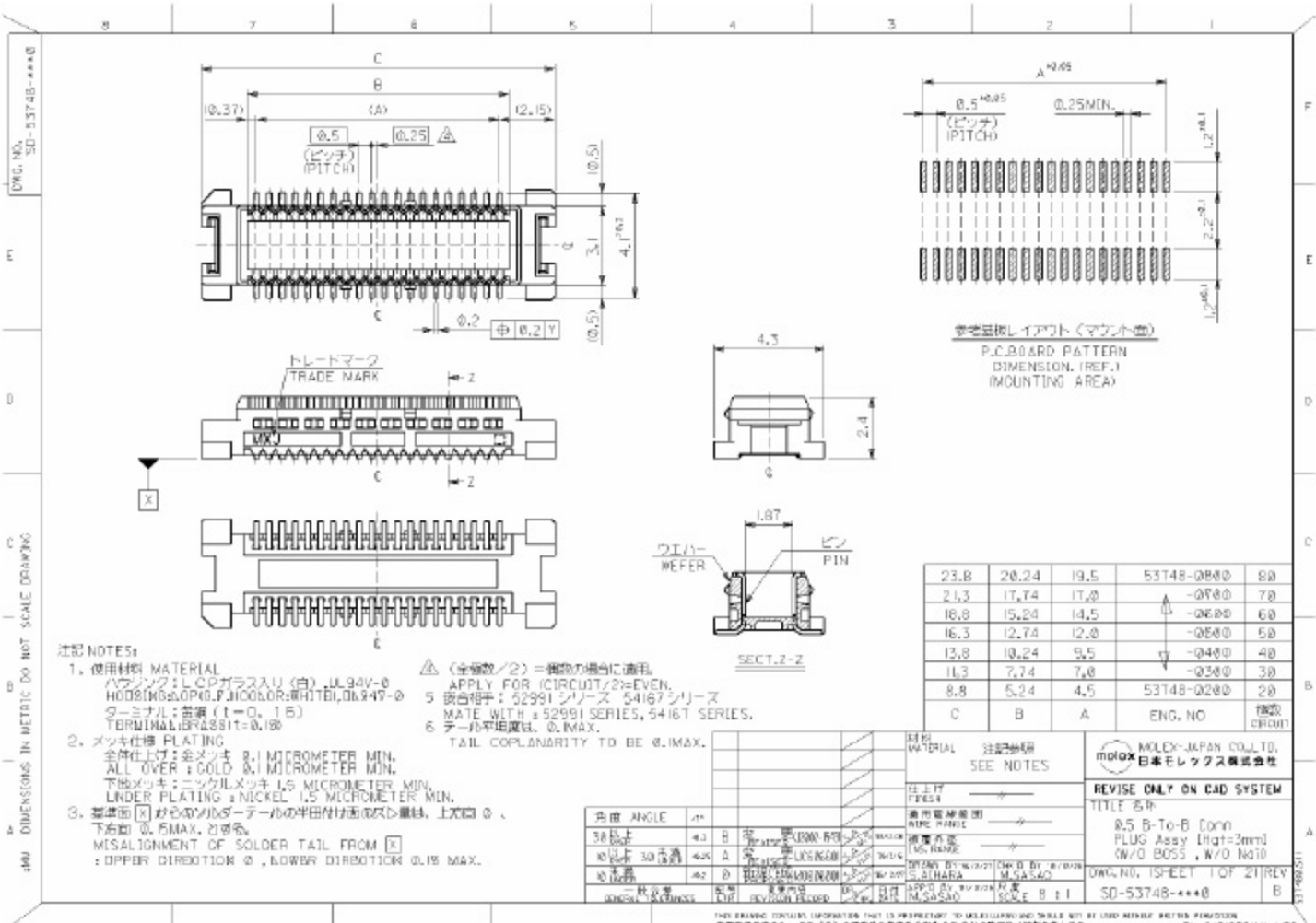

C	B	A	ENG. NO	極数 CIRCUIT
23.8	20.24	19.5	53748-0808	80
21.3	17.74	17.0	-0708	70
18.8	15.24	14.5	-0608	60
16.3	12.74	12.0	-0508	50
13.8	10.24	9.5	-0408	40
11.3	7.74	7.0	-0308	30
8.8	5.24	4.5	53748-0208	20

注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL
   ハウジング：LCPガラス入り（白）,UL94V-0
   HOUSING:LCP(GF),WHITE,UL94V-0
   ターミナル：黄銅（t=0.15）
   TERMINAL:BRASS(t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
   全体仕上げ：金メッキ 0.1 MICROMETER MIN.
   ALL OVER : GOLD 0.1 MICROMETER MIN.
   下地メッキ：ニッケルメッキ 1.5 MICROMETER MIN.
   UNDER PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.
3. 基準面 X よりのソルダーテールの半田付け面のズレ量は、上方向 0 、下方向 0.15MAX. とする。
   MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM X
   : UPPER DIRECTION 0 , LOWER DIRECTION 0.15 MAX.
4. （全極数／2）＝偶数の場合に適用。
   APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
5. 嵌合相手：52991シリーズ 54167シリーズ
   MATE WITH : 52991 SERIES, 54167 SERIES.
6. テール平坦度は、0.1MAX.
   TAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.

角度 ANGLE	.xx
30以上	±1
10以上 30未満	±2°
10未満	±3°
一般公差 GENERAL TOLERANCE	

改訂 REVISION	変更内容 REVISION RECORD	担当 DATE
B	新規作成 NEW DRAWING	98.11.06
A	寸法変更 DIMENSIONS CHANGED	99.1.6
0	新規作成 NEW DRAWING	98.7.20

材料 MATERIAL 注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
適用不可 NOT APPLICABLE

DRAWN BY 98/7/20 S.AIHARA
CHK'D BY 98/7/20 M.SASAO
APP'D BY 98/7/20 M.SASAO
尺度 SCALE 8:1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.5 B-To-B Conn
PLUG Assy [Hgt=3mm]
W/O BOSS , W/O Nail

DWG. NO. SD-53748-***0 | SHEET 1 OF 2 | REV B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ILLINOIS AND SHALL NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックスの財産情報を含むため許可なく複製等を禁じます。

EN-0(C)832(MX)-32

Figure 37: Mating board-to-board connector 53748-0808 on application